DIN IEC/TR 62627-01:2011-02 (D)

Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Teil 01: Reinigungsverfahren für Lichtwellenleiter-Steckverbinder (IEC/TR 62627-01:2010)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Begriffe 4

3 Allgemeines 4
3.1 Notwendigkeit der Reinigung von LWL-Verbindungen 4
3.2 Was ist die Quelle der Verschmutzung? 5
3.3 Was ist zur Reinigung erforderlich? 7
3.4 Auswirkungen der Verschmutzungen 8
3.5 Wann ist Reinigung erforderlich? 9

4 Prüfeinrichtung 9
4.1 Allgemeines 9
4.2 Prüfeinrichtung für das Reinigen freiliegender Steckverbinder-Endflächen 9
4.3 Prüfeinrichtung zur Reinigung der Anschlüsse 10
4.4 Reinigungsmaschinen 10
4.5 Prüfeinrichtung 11

5 Durchführung 11
5.1 Allgemeines 11
5.2 Verfahren zur Reinigung frei liegender Steckverbinder-Endflächen 12
5.3 Verfahren zur Reinigung von Anschlüssen 12

6 Erfahrungen 14

Literaturhinweise 16

Bilder

Bild 1 - Typische Beispiele für Verschmutzungen 6

Bild 2 - Ergebnisse der Steckung 7

Bild 3 - Migration der Schmutzstoffe 7

Bild 4 - Signalverschlechterung aufgrund von Verschmutzungen 8

Bild 5 - Bleibende Beschädigungen durch Verschmutzungen 9

Bild 6 - Prüfung eines Verbindungskabels und einer Kupplung 11

Bild 7 - Grundlegender Ablauf 11

Bild 8 - Trockene Reinigung 12

Bild 9 - Reinigung von Anschlüssen 13